

採用応募時の同意書(採用応募者用)

株式会社ビルドシステム

1. 個人情報の適切な保護と管理者

弊社は、次の者を個人情報の保護管理者として任命し、採用応募者の個人情報を適切かつ安全に管理し、個人情報の漏えい、滅失又はき損を防止する保護策を講じています。

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 1-3 NAビル 6階

株式会社ビルドシステム

個人情報保護管理責任者 渡邊 誠

TEL: 03-3526-2068

FAX: 03-3526-2069

2. 個人情報の利用目的

採用応募者の個人情報は、弊社の人事採用活動(書類審査、面接、評価、応募者への連絡等)のために利用いたします。

3. 個人情報の取り扱いの委託

弊社の業務の全部または一部を外部に業務委託する際、弊社は、個人情報を適切に保護できる管理体制を敷き実行していることを条件として委託先を厳選したうえで、機密保持契約を委託先と締結し、社員の個人情報を厳密に管理しています。

4. 個人情報を提供されることの任意性について

採用応募者ご自身の個人情報を弊社に提供されるか否かは、採用応募者のご判断によりますが、必要な情報をご提供されない場合には、採用において不利益を蒙る可能性がありますので予めご了承ください。

5. 履歴書の扱い

不採用の場合、提出していただいた履歴書は弊社が責任をもって処分いたします。

6. 採用応募者からの使用停止、削除等の申込みへの対応

採用応募者は、弊社に対してご自身の個人情報の開示等(利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止、第三者への提供の停止、消去)に関して、弊社問合わせ窓口に出すことができます。その際、弊社はご本人を確認させていただいたうえで、合理的な期間内に対応いたします。

なお、個人情報に関する弊社問合わせ先は、次の通りです。

株式会社ビルドシステム 個人情報保護管理責任者 渡邊 誠

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 1-3 NAビル 6階

TEL: 03-3526-2068

FAX: 03-3526-2069

私は上記の内容を理解したうえで同意致します。

年 月 日

氏名 (自署)